

株主の皆さまへ

第 39 期 報 告 書

2016年4月1日から2017年3月31日まで



株主の皆さまへ

■ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、当社第39期報告書（2016年4月1日から2017年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や世界経済の緩やかな回復基調を背景に輸出企業を中心に企業収益が改善する等、景気に明るさを感じられる状況となりました。一方、中国を始めとしたアジア新興国の経済減速や米国新政権の政策動向、英国のEU離脱問題等、世界経済の不確実性の高まりにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。

半導体業界におきましては、先端パッケージ分野への積極的な投資が進むなか、大手企業による寡占化が進行し優勝劣敗の様相が強まっております。また、IoT（モノのインターネット）や自動運転技術の中核となる半導体技術を目的に業種を超えた合従連衡が誕生する等、業界再編の動きも見られるようになりました。

半導体の需要としましては、中国製スマートフォンの高機能化や通信データ量の増加によるデータセンター向けサーバー用などの需要が増加しております。さらにIoTや車載向けを中心とした需要も増加する等、様々な用途向けの需要が引き続き堅調に推移いたしました。

この様な状況のもと当社グループは、中国におけるマーケットイン型の営業戦略展開やコンプレッション装置の優位性を活かしたパッケージ分野への浸透により、受注・売上を伸ばすことができました。

当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営施策の一つと考えており、競争力のある製品開発を目指す研究開発投資や生産性向上を目的とする設備投資、新たな市場への事業展開に係る投資、また、財務体質の改善等に必要の内部留保を確保した上で、各事業年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。

当事業年度の期末配当金につきましては、当社定款の定めに基づき、2017年5月11日開催の取締役会にて、第1次中期経営計画値を大きく上回る結果となったことに加え、安定的に利益を計上することが可能となったことから、当初予想から6円増額した1株当たり16円の配当を行うことを決議しております。なお、中間配当金を見送りとさせていただきますので、年間の配当金は1株当たり16円となります。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長 **岡田博和**

2017年6月

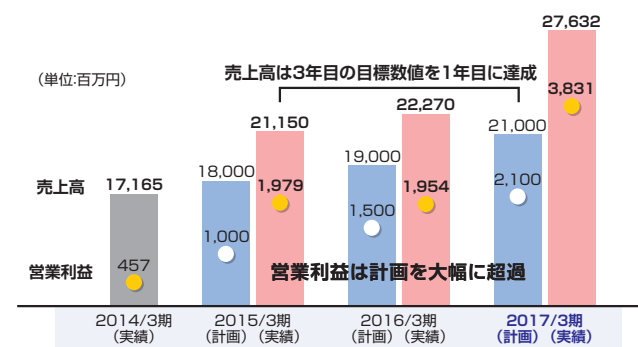
第39期の概況と今後の方針

中国の半導体産業育成国家戦略による設備投資拡大を当社の中国販売拠点および生産拠点が一体となり、マーケットイン型の営業戦略を展開することで確実に受注・売上へとつなげてまいりました。また微細化、薄型化、積層化が進むパッケージには、当社独自技術のコンプレッション装置の優位性を活かし、お客様のニーズを捕捉することでマーケットへの浸透を図ってまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における受注高は279億75百万円（前連結会計年度比49億78百万円、21.6%増）、売上高276億32百万円（前連結会計年度比53億61百万円、24.1%増）、営業利益38億31百万円（前連結会計年度比18億77百万円、96.1%増）、経常利益41億31百万円（前連結会計年度比20億38百万円、97.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益38億67百万円（前連結会計年度比20億41百万円増、2.1倍）となり、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高を記録することができました。

第39期は、2014年に掲げた「TOWA10年ビジョン」の達成に向け策定した第1次中期経営計画（2014年度～2016年度）の最終年度でしたが、期初の計画を大きく上回ることができました。

2017年4月からは、「挑戦」と「飛躍」を合言葉とした第2次中期経営計画をスタートしております。IoT（モノのインターネット）や自動運転技術、AI（人工知能）等の様々な用途で拡大が期待される半導体市場で更なる優位性を確保し高い市場シェアを維持し続けるための諸施策と、創造の力によるコア技術を応用展開した新たな市場への取り組みを進めてまいります。



中期(3カ年)経営計画進捗状況

第2次中期経営計画（2017年度～2019年度）

テーマ：「エンパワーメントで挑戦と飛躍を」

TOWAのエンパワーメントとは：従業員の自主的・自律的な行動を促し、組織としてのパフォーマンスを最大化すること。

事業方針

- ◆最先端パッケージ市場での更なる優位性の確保と既存パッケージ市場の掘り起こし
- ◆成形品事業の新市場開拓による業績拡大
- ◆トータル・ソリューション・サービス(TSS)事業と新事業への経営資源投入による収益機会の拡大
- ◆コーポレート・ガバナンスの強化による更なる企業価値の向上

業績計画

(単位：億円)

項目	期別	2018年3月期 (計画)	2019年3月期 (計画)	2020年3月期 (計画)
売上高	2018年3月期	295 (295)	325	355
	半導体製造装置事業	242	260	277
	ファインプラスチック事業	13	15	16
営業利益	2018年3月期	38 (40)	42	46
	2019年3月期	38 (41.5)	42	46
当期純利益	2018年3月期	26 (28.5)	29	32

※当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益
※括弧書きは2017年5月11日公表の連結業績予想値

生産力強化 中国・蘇州工場を増築

2017年2月、中国の生産子会社であるTOWA半導体設備(蘇州)有限公司の工場を約1.5倍(延べ床面積比)に増築しました(右写真の赤丸部分)。

2017年内をめどに、半導体関連設備の生産能力を約2倍に高める計画です。生産品目は、中国市場向けのモールド装置や半導体を個片化するシンギュレーション装置、先端パッケージ生産に高評価を受けているコンプレッション装置などが中心です。

また、新たに研究開発機能や装置のトレーニングセンターも備え、お客様の迅速な研究開発を支援するとともに、サービスの充実を図ります。



アフターサービス事業の充実

LEプログラムを開始

2017年4月より、当社が過去に納入したモールド装置をお客様の要望に応じて改良、変更等する「LEプログラム」(Life Extension Program)を開始しました。当社がこれまで納入した装置のうち3,000台以上が現在も稼働中であり、お客様からは、長く使い込んだ装置を新しいデバイスに適用したいというご要望をいただいております。装置の改良、変更に加え、リファビッシュ、オーバーホールなどのサービスも提供し、ご要望に応じてまいります。

顧客満足向上

装置の納期を1ヶ月に短縮

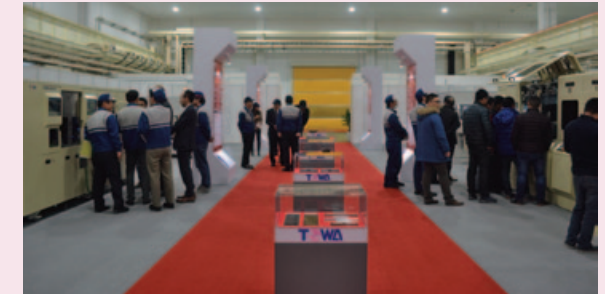
当社は、コンプレッション方式のモールド装置(PMC1040-D)の納期を、1ヶ月に短縮することに成功しました。これまで、受注から出荷までに3ヶ月を要していましたが、コンカレントエンジニアリング手法と呼ばれる製造期間短縮方法を導入し、納期短縮を達成しました。

2017年4月受注分より開始しており、生産の早期立ち上げや、新製品の投入時期を柔軟に変更したいというお客様の要望に応じてまいります。また、今後は対象機種を広げていく予定です。

蘇州(中国)でプライベートショーを開催

2017年2月17日の蘇州工場の竣工式に引き続き、プライベートショーを開催しました。2月24日までの開催期間中に政府関係者やお取引先など258名の方にご来場いただき、当社のモールド装置やシンギュレーション装置をご覧いただきました。

ご来場者の反応も良好で、当社製品に興味を持たれた様子でした。当社は、これからも現地関係者とのつながりを強化してまいります。



JIMTOF 2016 出展



2016年11月17日から22日までの6日間、東京ビッグサイトで開催された「JIMTOF 2016」に出展いたしました。同展示会は最先端の工作機械が一同に集結する見本市であり、国内外から969社が出展、約15万人が来場しました。当社は初出展でしたが、CBNエンドミルや車載用部品等の受託加工品、またバンセラコーティングを施したサンプルの展示や大型モニターを使用した技術紹介を行い、ブースには約500名の方にご来訪いただきました。来訪者の方々には当社の技術力の高さを知っていただくことができ、微細加工分野における当社の知名度向上につながりました。これを機会に販路拡大に努めてまいります。

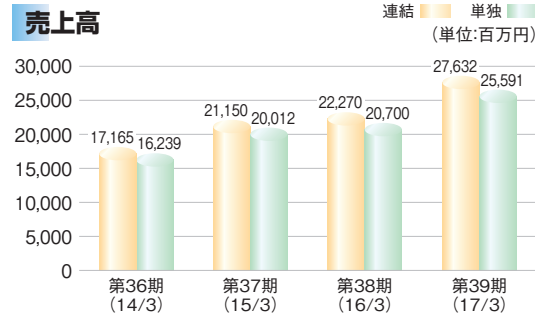
京都ハンナリーズへの協賛開始

当社は、京都に拠点を置くプロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」のオフィシャルパートナーとして協賛を開始しました。ハンナリーズアリーナ(西京極体育館)で開催されるホームゲームでは、社名の広告掲載や会場内アナウンスが流れ、地域貢献とともに、企業イメージの向上を図っています。

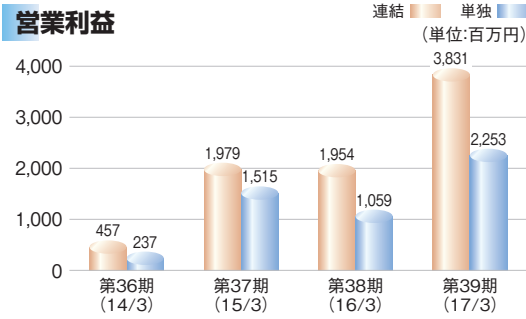


業績の推移

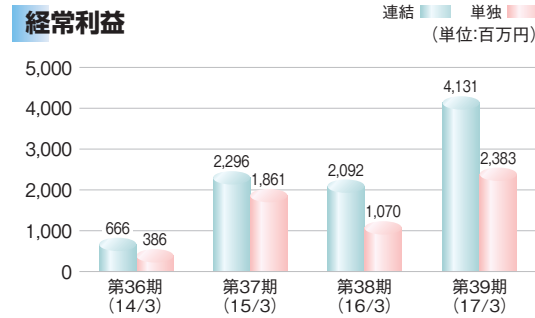
売上高



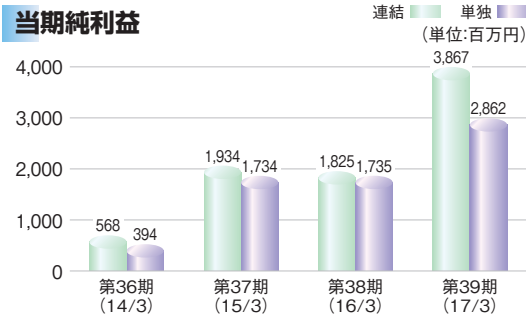
営業利益



経常利益

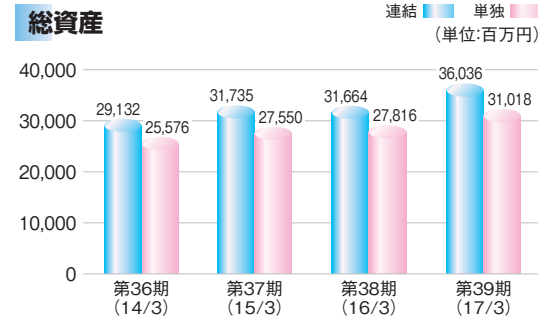


当期純利益

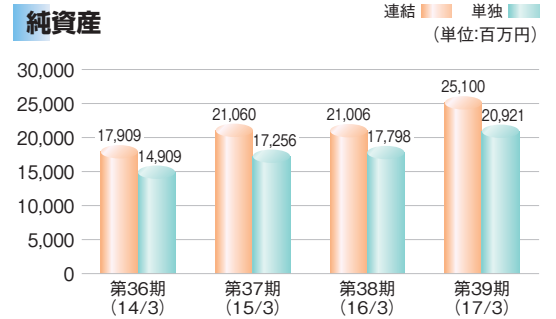


(注)連結については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。

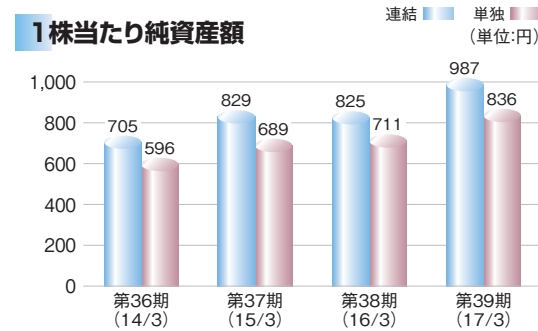
総資産



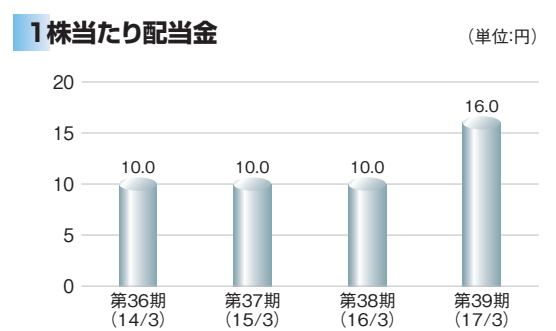
純資産



1株当たり純資産額

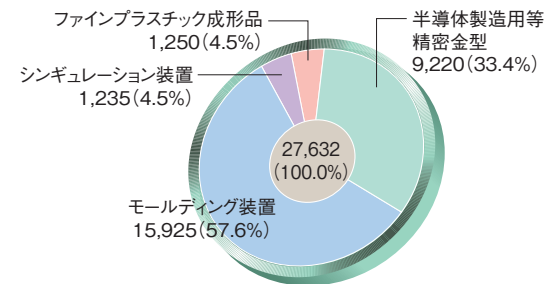


1株当たり配当金

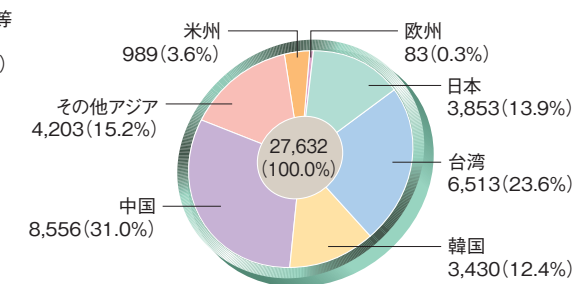


[セグメント別連結売上高(第39期)]

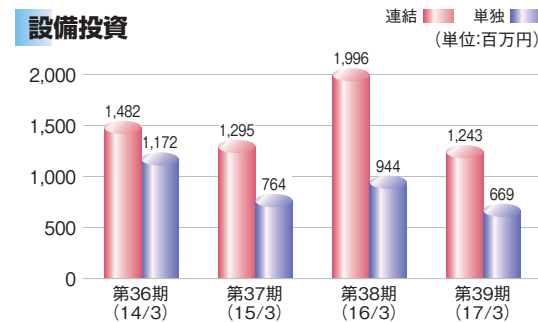
製品別 (単位:百万円)



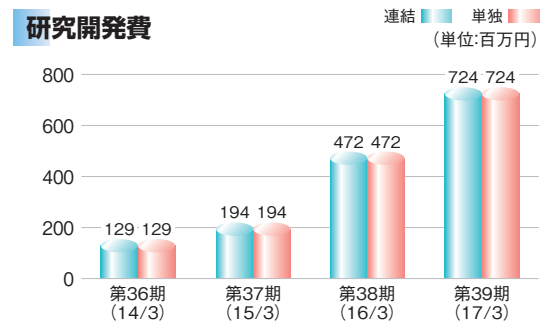
地域別 (単位:百万円)



設備投資



研究開発費



(注)当連結会計年度より会計方針の変更(収益認識基準の変更)を行っているため、前期末(16/3)について遡及適用後の数値を記載しております。

決算概要

連結貸借対照表 (2017年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
【資産の部】	
流動資産	20,766
現金および預金	5,852
受取手形および売掛金	8,058
電子記録債権	67
たな卸資産	5,739
その他	1,050
固定資産	15,270
有形固定資産	11,442
建物および構築物	4,514
土地	4,489
その他	2,439
無形固定資産	684
投資その他の資産	3,143
資産合計	36,036

(注) 当期の連結子会社は13社であります。

連結損益計算書

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額
売上高	27,632
売上原価	17,947
売上総利益	9,685
販売費および一般管理費	5,853
営業利益	3,831
営業外収益	362
営業外費用	62
経常利益	4,131
特別利益	12
特別損失	7
税金等調整前当期純利益	4,136
法人税・住民税および事業税	730
法人税等調整額	△ 515
当期純利益	3,921
非支配株主に帰属する当期純利益	53
親会社株主に帰属する当期純利益	3,867

科目	金額
【負債および純資産の部】	
流動負債	8,574
支払手形および買掛金	3,474
短期借入金	1,000
一年以内返済予定長期借入金	1,235
その他	2,865
固定負債	2,361
長期借入金	1,626
その他	735
負債合計	10,936
株主資本	23,052
資本金	8,932
資本剰余金	462
利益剰余金	13,667
自己株式	△ 9
その他の包括利益累計額	1,642
その他有価証券評価差額金	1,451
為替換算調整勘定	12
退職給付に係る調整累計額	178
非支配株主持分	406
純資産合計	25,100
負債・純資産合計	36,036

連結キャッシュ・フロー計算書

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,054
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,194
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,020
現金および現金同等物の期末残高	5,757

連結株主資本等変動計算書 (2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2016年4月1日 期首残高	8,932	462	10,979	△ 9	20,364
会計方針の変更による累積的影響額			△ 929		△ 929
会計方針の変更を反映した2016年4月1日 期首残高	8,932	462	10,049	△ 9	19,435
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 250		△ 250
親会社株主に帰属する当期純利益			3,867		3,867
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	3,617	△ 0	3,616
2017年3月31日 期末残高	8,932	462	13,667	△ 9	23,052

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
2016年4月1日 期首残高	939	287	△ 11	1,215	367	21,947
会計方針の変更による累積的影響額					△ 11	△ 941
会計方針の変更を反映した2016年4月1日 期首残高	939	287	△ 11	1,215	355	21,006
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△ 250
親会社株主に帰属する当期純利益						3,867
自己株式の取得						△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	511	△ 274	189	426	50	477
連結会計年度中の変動額合計	511	△ 274	189	426	50	4,094
2017年3月31日 期末残高	1,451	12	178	1,642	406	25,100

会社の概要

商号	TOWA株式会社 (英文名TOWA CORPORATION)		
設立	1979年4月17日		
資本金	8,932,627,777円		
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250(代表)		
従業員数	457名		
役員	代表取締役社長	岡田博和	
(2017年6月29日現在)	取締役常務執行役員	浦上浩	
	取締役常務執行役員	田村吉住	
	取締役上席執行役員	石田耕一	
	取締役常勤監査等委員	小林久芳	
	社外取締役監査等委員	桑木肇	
	社外取締役監査等委員	和氣大輔	
	執行役員	蒲生喜代重	
	執行役員	伊藤篤二	
	執行役員	高瀬慎	
	執行役員	早坂昇	
ホームページ	http://www.towajapan.co.jp		
上場取引所	東京証券取引所市場第一部		

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年		
定時株主総会	毎年6月		
基準日	株主総会権利行使および期末配当	3月31日	
	中間配当	9月30日	
単元株式数	100株		
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社		
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部		
郵便物の郵送先および 電話お問合せ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324(フリーダイヤル)		
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります)		
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、 やむをえない事由により電子公告を することができない場合は、日本経済新聞 に掲載します。 公告掲載URL http://www.towajapan.co.jp		

株式の状況 (2017年3月31日現在)

●発行可能株式総数	80,000,000株
●発行済株式の総数	25,021,832株
●株主数	6,632名
●大株主	

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	4,344千株	17.37%
株式会社ケイビー恒産	2,000	8.00
蒲生徳子	1,398	5.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,152	4.61
資産管理サービス信託銀行株式会社	1,045	4.18
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW	811	3.24
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/ JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	700	2.80
株式会社京都銀行	699	2.80
坂東幸子	510	2.04
K I A F U N D 1 3 6	396	1.59

(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(11,698株)を控除して計算しております。

TOWAグループ (2017年3月31日現在)

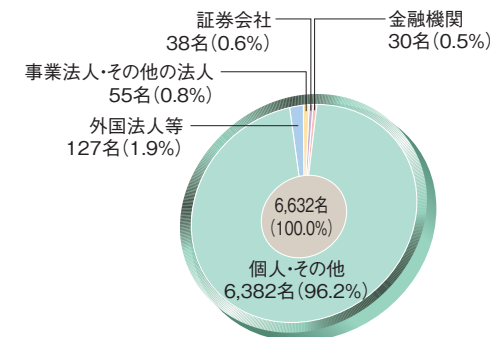
■国内

TOWA株式会社
本社・工場
京都東事業所
坂東記念研究所
九州事業所
東京営業所
株式会社バンディック
TOWATEC株式会社

■海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp. (フィリピン)
TOWA USA Corporation (米国)
TOWA Europe B.V. (オランダ)
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)
東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)
上海沙迪克軟件有限公司 (中国)
蘇州STK鑄造有限公司 (中国)
台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)
TOWA韓国株式会社 (韓国)
株式会社東進 (韓国)

■所有者別株主数分布



■所有者別株式数分布

